

EG95-JP

ソフトバンクネットワーク対応の通信モジュール、EG95-JPのご紹介です。



EG95-JP

Quectel製
LTE通信モジュール
(LGA Type)



特長

- ・4G対応
- ・パケット通信対応
- ・SMS対応
- ・FOTA対応
- ・VoLTE対応
- ・グローバルマルチバンド

スペック

製品名	EG95-JP
サイズ	29.0mm × 25.0mm × 2.45mm (H × W × D)
重量	4.2g
通信方式	FDD-LTE/TDD-LTE
周波数	FDD-LTE :B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE:B41
電源電圧	DC3.3- 4.3V
消費電流	通信時：500-1300mA 待機時：24mA
外部インターフェース	USB/UART/I2C/PCM/SPI
制御コマンド	AT Command
動作環境	動作温度：-35～75 ° C
取得済み認証	JATE/TELEC

本製品はQuectel株式会社より販売します

▶ 詳細は製品メーカーWebサイトへ

<https://www.quectel.com/product/lte-eg95-series/>

※パンフレットの記載内容は、2025年4月9日時点のものです。

製品のお問い合わせはこちら

<https://tm.softbank.jp/form/inquiry/m2m/index.php>

○ SoftBankおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。

○ 記載のロゴ、会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。